

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2025-008

芯原微电子（上海）股份有限公司

2024年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） |
|------------------------|------------|------------|---------------|
| 营业总收入 | 232,258.81 | 233,799.64 | -0.66 |
| 营业利润 | -59,178.65 | -27,071.86 | 不适用 |
| 利润总额 | -59,056.44 | -26,922.36 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -60,523.74 | -29,646.67 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | -64,363.27 | -31,807.00 | 不适用 |
| 基本每股收益（元） | -1.21 | -0.59 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | -25.18% | -10.54% | 下降 14.64 个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（%） |
| 总资产 | 464,142.63 | 440,638.10 | 5.33 |
| 归属于母公司所有者的所有者权益 | 211,803.33 | 270,029.36 | -21.56 |
| 股本 | 50,035.51 | 49,991.12 | 0.09 |
| 归属于母公司所有者 | 4.23 | 5.40 | -21.67 |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 的每股净资产（元） | | | |
|-----------|--|--|--|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2024 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2020 年至 2022 年，公司营业收入复合增长率约为 33%。2021 年，在行业产能紧张的情况下，公司实现量产业务收入同比增长约 35%，营业收入同比增长约 42%，实现净利润扭亏为盈。2022 年，全球半导体产业下行，公司营业收入逆势增长约 25%，净利润与扣非后净利润均实现盈利，成功实现了“摘 U”。2023 年，在产业环境非常艰难的情况下，公司仍然保持了上半年净利润、扣非后净利润均为正。受全球经济增速放缓，半导体行业周期下行以及去库存的影响，公司仅三个季度收入同比下滑。2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，公司自二季度起，经营情况快速扭转。公司 2024 年第二季度营业收入规模同比恢复到受行业周期影响前水平，2024 年第三季度营业收入创历年三季度收入新高，同比增长 23.60%，第四季度收入同比增长超 17%，全年营业收入预计基本与 2023 年持平。2024 年下半年，公司芯片设计业务收入同比增长约 81%，知识产权授权使用费业务收入同比增长约 21%，量产业务收入同比下降约 4%。2024 年第四季度，公司芯片设计业务收入同比增长约 81%，知识产权授权使用费业务收入同比下降约 28%，量产业务收入同比增长约 32%，体现了公司收入受行业下行周期影响较晚、恢复增长较早的特点。

截至 2024 年末，公司订单情况良好，在手订单 24.06 亿元，较三季度末的 21.38 亿元进一步提升近 13%，在手订单已连续五季度保持高位。从新签订单角度，2024 年四季度公司新签订单超 9.4 亿元，2024 年下半年新签订单总额较 2024 年上半年提升超 38%，较 2023 年下半年同比提升超 36%，较半导体行业周期下行及去库存影响下的 2023 年上半年大幅提升超 66%，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。

经过 20 多年的持续高研发投入，公司已经拥有丰富且优质的人才和技术储

备，并在别的公司不招人、少招人的情况下，芯原逆向思维，在 2024 届校招中近 1 万人进行了全球统一在线笔试，约 1,800 人进入面试环节，我们录取了 200 多名应届毕业生，其中，硕士 985、211 的占比为 97%，其中本硕都是 985、211 的占比 85%。

公司潜心投入关键应用领域技术研发，如五年前开始布局 Chiplet 技术及其在生成式人工智能和智慧驾驶上的应用。公司在三年前就开始研发超轻量、超低功耗的 AI/AR 眼镜芯片设计平台，为全球知名的互联网企业定制了 AR 眼镜专用芯片，还与其始终在线的开源项目展开深度合作，形成了完整的技术平台。

由于在产业下行周期客户项目短期有所减少，公司较以往加大了研发投入的比重，2024 年度研发费用同比增加约 32%。随着公司芯片设计业务订单增加，2024 年下半年芯片设计业务收入同比大幅增加约 81%，研发资源已逐步投入至客户项目中，预计未来公司研发投入比重将会下降，恢复到正常水平。目前公司已积累了充分的技术和人力资源，技术能力业界领先，并持续获得全球优质客户的认可。

三、风险提示

本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日